



GDT-9700

MicroPC rugged fanless con Compute
Module performance Core i3 Core i5
Core i7

Basato sui nuovi NUC Intel® Compute Elements (U-Series), il GDT-9700 è un BOX PC rugged e fanless per applicazioni verticali disegnato con un concetto di elevata modularità. L'elemento che contiene la CPU, il Chipset e l'interfaccia Wireless LAN può essere accoppiato con tre diverse schede carrier caratterizzate da un numero diverso di porte di I/O per indirizzare specifiche esigenze di mercato.

Disponibile in due diverse configurazioni I/O

Il GDT-9700 è integrato in uno chassis in estruso di alluminio estremamente robusto, in grado di garantire una eccellente resa termica e protetto da agenti esterni grazie alla dotazione di tappi in gomma applicabili opzionalmente a tutte le porte di I/O e dotato di serie anche di due antenne esterne per un raggio di copertura Wireless molto ampio.

Box PC Rugged Modulare e Fanless

Il BOX PC rugged e fanless basato sulla nuovissima architettura modulare Intel® che permette l'upgrade nel tempo **del solo modulo CPU**, garantendo longevità alla piattaforma salvaguardando l'investimento iniziale. Il contenitore di dimensioni ridotte può essere fissato retro monitor o a parete grazie all'apposita staffa in dotazione, che alloggia anche l'alimentatore esterno per installazioni ordinate.



Chassis Rugged per impiego in ambienti ostili

Il GDT-9700 è integrato in uno **chassis in estruso di alluminio** estremamente robusto, in grado di garantire una eccellente resa termica (0-40°C) e protetto da agenti esterni grazie alla dotazione di tappi in gomma applicabili opzionalmente a tutte le porte di I/O e dotato di serie anche di due antenne esterne per un **raggio di copertura Wireless molto ampio**.

Ha un design senza ventole e parti in movimento, **certificato IP50** per livelli minimi di intrusione delle particelle, con tappi in gomma di protezione per le porte di I/O non utilizzate. E' progettato per durare ed è idoneo a un'operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, una caratteristica fondamentale per applicazioni professionali sia in ambito Industry 4.0, sia in applicazioni Retail o embedded.



Architettura Modulare e Aggiornabile

Il GDT-9700 è un embedded box PC fanless per applicazioni verticali disegnato con un concetto di elevata modularità, basato sui **nuovi Intel® Compute Elements (U-Series)**, dei sottoinsiemi che contengono la CPU, il Chipset e l'interfaccia Wireless LAN e possono essere accoppiati con due diverse schede carrier caratterizzate da un numero diverso di porte di I/O per indirizzare specifiche esigenze di mercato.

Il modulo I/O può essere opzionalmente e alternativamente configurato (opzione di fabbricazione):



Configurazione 1:

- 2 porte USB sul frontale (1x USB 2.0 e 1x USB 3.2 Gen 1.)
- 2 porte USB 2.0 posteriori
- 2 porte USB 3.2 Gen.1 posteriori
- 2 porte HDMI
- 2 porte LAN Gbit
- 2 socket per SSD in formato M.2 configurabili in RAID 1

Configurazione 2:

- 2 porte USB sul frontale (1x USB 2.0 e 1x USB 3.2 Gen 1.)
- 2 porte USB 3.2 Gen.1 posteriori
- 6 porte HDMI
- 1 porte LAN Gbit
- 2 socket per SSD in formato M.2 configurabili in RAID

Il Compute Module Intel

Il GDT-9700 è basato sui nuovi Compute Module Intel®, che integrano in un unico package, i processori Core i3 , i5 e i7 di 11a generazione, la memoria RAM, il chipset e la scheda Wireless LAN.

In questo modo il sistema potrà essere aggiornato alle nuove generazioni di Compute Module previste per i prossimi anni, lasciando inalterati lo chassis, l'alimentazione e le porte di I/O, garantendo quindi un upgrade tecnologico e prestazionale a costi contenuti salvaguardando le interconnessioni esistenti.



Scheda tecnica

Generale

Processore	Intel® Core™ i3, i5, i7 di undicesima generazione	TDP Processore	15W TDB
Memoria base / max / n. socket	8GB / 16GB	Kensington Lock	Si
Alimentazione	Alimentatore esterno 19V 90W	Montaggio a parete	Staffa per montaggio retro monitor con supporto alimentatore
Storage integrato	2 SSD SATA M.2 configurabili in RAID 1	Temp. utilizzo	Temperatura operativa: 0-40°C con dischi SSD
WiFi	integrata su Compute Module con antenne esterne	Fanless	si
Caratteristiche chassis	Estruso di alluminio verniciato (nero)		

Porte di I/O

Porte Seriali	2 x Seriale DB9 (opzionali)	Porte LAN	1 x Gbit Ethernet (configurazione opzionale con 2 x Gbit)
Porte USB	3 x USB 3.0 + 1 USB 2.0 (2 porte USB 3.0 con modulo aggiuntivo)	Porte video	2 x HDMI (configurazione opzionale con 6 porte HDMI)

Sistemi Operativi

Windows	Windows10 / 11 PRO Embedded e IoT 2019 / 2021	Linux	Linux UBUNTU LXDE
---------	---	-------	-------------------

Qualità

Certificazioni CE, RoHS...	Direttive CE: Emissioni: EN 55022 , EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, Immunità: EN 55024 , Sicurezza: EN 60950
----------------------------	--

Garanzia

Standard	12 mesi on-center presso sede FEC Italia	Opzionale	estensioni fino a 3 anni on-center
----------	--	-----------	------------------------------------

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A)	254 x 152 x 36 mm	Peso	2kg ca
------------------------	-------------------	------	--------